



大扭矩触控式薄型 SRBD系列

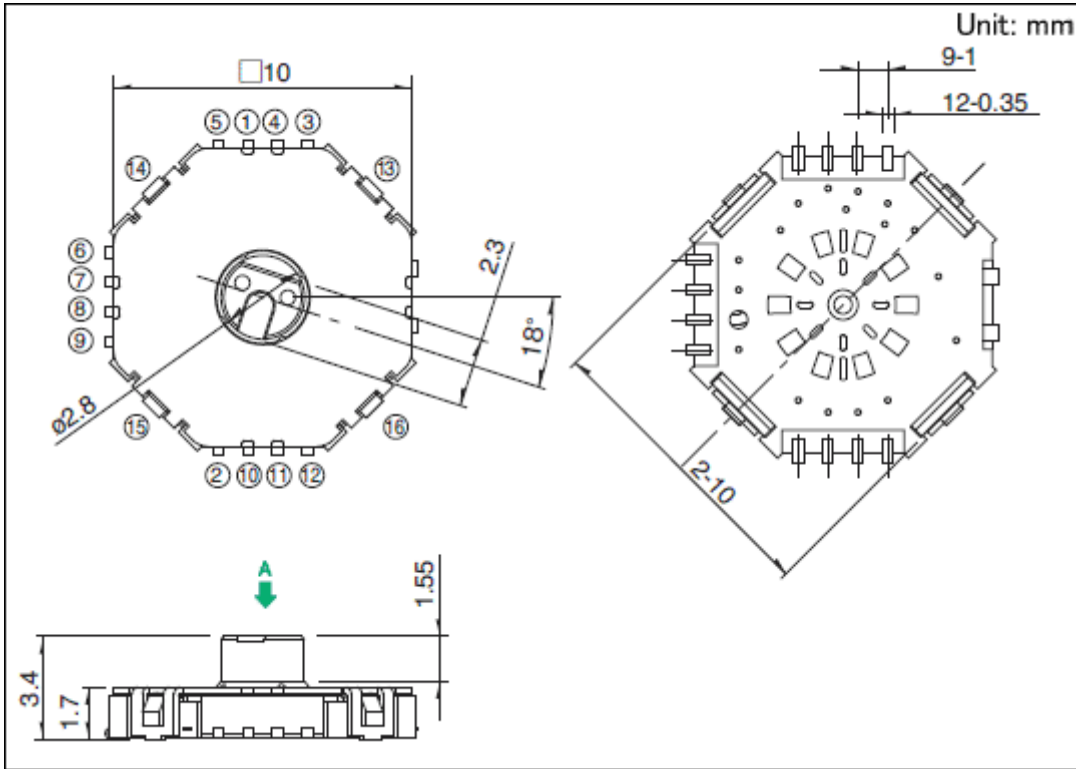
电路数			1
接点数			10
切换角度			36°
定位数			7
定位销			无
切换时限			Non shorting
旋转扭矩			13±5mN·m
焊接方法			For PC board (Reflow)
操作部长度			1.7mm
使用温度范围			-25℃ to +85℃
最大额定/最小额定(电阻负载)			1mA 5V DC/50μA 3V DC
电性能	接触电阻(初期/寿命后)	200mΩ max./200mΩ max.	
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC	
	耐电压	100V AC for 1 minute	
机械性能	端子强度	3N for 1 minute	
	操作部强度	推进方向	50N
耐久性能	无负载寿命	10,000 cycles 250mΩ max.	
	负载寿命(最大额定负载)	10,000 cycles 250mΩ max.	
耐环境性能	耐寒性能	-40±2℃ for 500h	
	耐热性能	85±2℃ for 500h	
	耐湿性能	60±2℃, 90 to 95%RH for 500h	
最小订货单位(pcs.)	日本	1,200	

关于本网站的cookie：

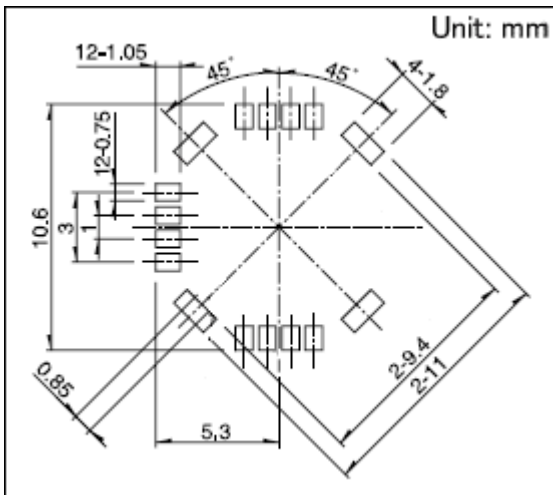
本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受

外形图



焊接处尺寸图



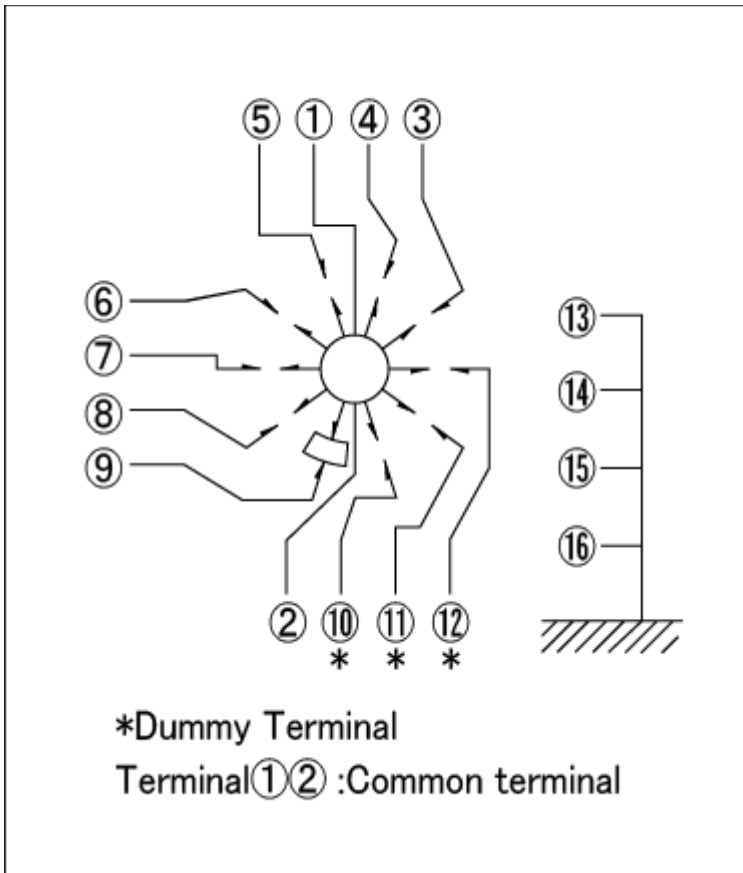
自A方向看。

电路图

关于本网站的cookie：

本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受



虚拟端子

position No.	Terminal No.	Detent
1	③	○
2	④	○
3	⑤	○
4	⑥	○
5	⑦	○
6	⑧	○
7	⑨	○
8	⑩	—
9	⑪	—
10	⑫	—

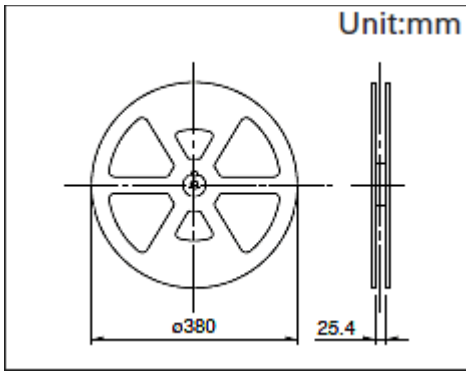
包装规格

载带

关于本网站的cookie：

本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受



捆包数(pcs.)	1卷	1,200
	1箱/日本	2,400
	1箱/出口包装	4,800
载带宽度(mm)		24
出口包装箱尺寸(mm)		428×413×172

焊接条件

回流方式的参考举例

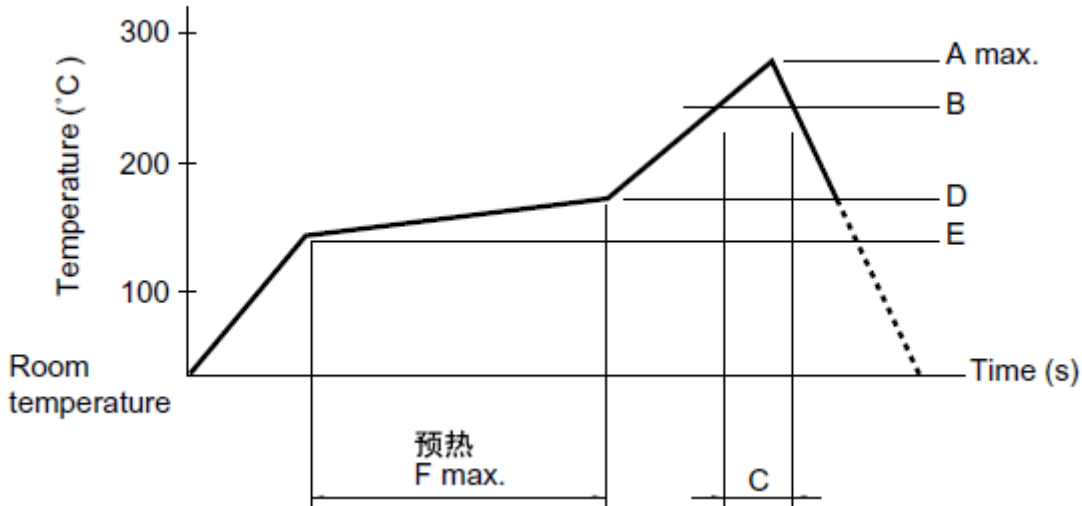
1. 加热方式

远红外线加热的上下加热方式。

2. 温度测量方式用

φ0.1~φ0.2的CA (K) 或CC (T) 测量。位置在焊接连接部 (铜箔面) 测量。固定方式采用耐热胶带。

3. 温度分布



A(°C)	B(°C)	C(s)	D(°C)	E(°C)	F(s)
260	230	40	180	150	120

(1) 上述条件，为印刷电路板的零部件贴装面上的温度，根据电路板的材质，大小，厚度等，电路板温度和开关表面温

关于本网站的cookie：

本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受

表示本系列共通的注释。

1. 本产品目录中产品的颜色，与实物的颜色有所差异。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。

关于本网站的cookie：

本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受